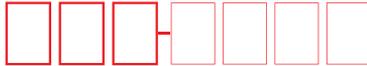




郵便はがき



株主通信

第14期上半期

自平成27年4月1日 至平成27年9月30日



株式会社ジエダット <証券コード:3841>

株主名簿管理人 事務取扱所

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部

〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4

電話お問合せ先 0120-288-324 (フリーダイヤル)

中面にお知らせがあります。万一ぬれている場合はよく乾かしてからご覧ください。

新製品シリーズ "SX-Meister" を発表

当社は2015年10月1日、主力製品である α -SXの次世代ブランド『SX-Meister (エスエックス マイスター)』を発表いたしました。IoT時代に向かって、カスタム設計での新たな設計ツールのコンセプトを提案いたします。



アナログ、メモリー、パワー、液晶、MEMS等のデバイスのカスタム設計においては、製品の性能、品質や設計効率が設計者のスキルや経験により大きく影響されます。しかしながら、熟練設計者(=匠)の技を他の設計者や新人設計者がシステム的に利用することは非常に困難でした。

SX-Meisterでは、熟練設計者の設計過程、設計パラメータ、さらには操作方法という「匠の要素」の定量化・見える化を行い、新規設計やプロセスマイグレーション設計での最適設計に適用できるようにする機能をご提供致します。

また、SX-Meisterではこのほか、iPDKのサポート、スマートGUI、データベースの高速化などの基盤技術も改善します。

SX-Meisterは、2016年第2四半期から順次リリースを行う予定です。

株式数及び株主数 (平成27年9月30日現在)

発行可能株式総数	7,800,000株
発行済株式総数	1,950,000株
株主数	681名

株主メモ

上場市場	東京証券取引所 JASDAQ市場 (スタンダード)
事業年度	4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
配当基準日	3月31日
株式の売買単位	100株
株主名簿管理人	東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社
公告掲載方法	電子公告とし、次の当社ホームページに掲載します。 http://www.jedat.co.jp/ ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告をすることができない場合は日本経済新聞に掲載します。

会社概要

商号	株式会社ジエダット (Jedat Inc.)
所在地	〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-4-14 OZAWAビル
代表者	代表取締役社長 河内 一往
営業開始	平成16年2月2日
資本金	760,007,110円
事業内容	電子回路・半導体集積回路・液晶モジュール等設計支援のためのソフトウェア開発・販売及びコンサルテーション

株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、平素より当社企業グループに格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。平成28年3月期上半期の業績をご送付申し上げます。

当社企業グループの主要顧客である半導体およびFPD(Flat Panel Display)等の国内電子部品業界では、国内景気の回復基調が徐々に鈍化する中、売上高、収益ともに横ばい傾向になりつつあります。自動車やIoT(Internet of Things)関連向けは依然として高い業績を維持しておりますが、スマートフォン関連向けは中国における需要の伸び悩みを受けて、先行きに陰りが見られるようになってきました。

このような状況の中、当社企業グループは、国内市場では、引き続き好調なセンサーデバイス、ディスプレイデバイス、パワーデバイス等の分野にフォーカスして販売活動を行いました。加えてアナログ半導体設計向けに新製品を投入し、代理販売製品のラインナップを拡充することで、売上の拡大を図りました。ソリューション・ビジネスにおいては、設計委託需要の拡大に対応して設計者の大幅増員を実施し、EDAアウトソーシングサービスも本格始動しました。海外市場では、国際的な展示会・学会に新製品を出展し、また中国を始めとした各国代理店構成の見直しを実施することで、半導体市場向け販売力の強化を図りました。

このような活動の結果、ソリューション・ビジネスおよび海外向けの売上が大幅に伸長したことにより、当第2四半期連結累計期間の売上高は前年同四半期と比較して73百万円(10.3%)増加して7億86百万円となり、営業利益は65百万円(前年同四半期比55.4%増)、経常利益は63百万円(同13.7%増)となりました。中国子会社出資金の売却による特別損失の計上ならびに繰延税金資産の計上等により、親会社株主に帰属する四半期純利益は34百万円(同40.0%減)となりました。

当下半期におきましても当社は、先行き不透明な感の強い国内市場への対抗策といたしまして、海外市場への拡販を加速、また、半導体設計受託サービスの拡大や、EDAアウトソーシングサービスの立ち上げにも注力してまいりたいと存じます。

株主の皆様には引き続き、変わらぬご理解とご支援を賜りますよう、どうかよろしくお願ひ申し上げます。

代表取締役社長 河内 一往



第2四半期累計期間 セグメント別売上高 (単位:百万円)

	平成27年 3月期	平成28年3月期		
	実績	計画	実績	前年同期比
製品	378	396	393	+ 3.9%
サービス	260	240	257	△0.9%
ソリューション	74	180	134	+ 81.9%
半導体市場	364	482	463	+ 27.1%
FPD市場	348	333	322	△7.3%
自社開発製品	555	638	641	+ 15.5%
代理販売製品	157	177	144	△8.1%
売上高合計	712	816	786	+ 10.3%

財務ハイライト (単位:百万円)

